

2026-2032年中国聚合物基导热界面材料（TIM） 行业市场发展态势及发展趋向研判报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2026-2032年中国聚合物基导热界面材料（TIM）行业市场发展态势及发展趋向研判报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/1246053.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 400-600-8596、010-60343812、010-60343813

电子邮箱: kefu@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

报告导读：

聚合物基导热界面材料（TIM）作为电子热管理核心材料，以聚合物为基体、高导热填料为功能相，按应用位置分为高标准的TIM1与性能要求较低的TIM2。在国家新材料产业相关政策扶持下，行业受益于AI、5G、新能源汽车等下游领域驱动，全球及中国市场规模稳步扩张，且中国市场增速高于全球。其中，“AI+”浪潮拉动电子器件高端散热需求，数据中心、ADAS等领域突出，预计2033年ADAS相关TIM市场规模达6亿美元。当前竞争格局呈现国际巨头主导高端市场、本土企业加速追赶突破的态势，回天新材等本土龙头通过技术攻关切入高端供应链。未来，行业将围绕技术升级、国产替代与场景适配三大方向发展，ADAS、数据中心等细分领域将成为重要增量市场，定制化解决方案与产业链协同将成竞争核心。

基于此，依托智研咨询旗下聚合物基导热界面材料（TIM）行业研究团队深厚的市场洞察力，并结合多年调研数据与一线实战需求，智研咨询推出《2026-2032年中国聚合物基导热界面材料（TIM）行业市场发展态势及发展趋向研判报告》。本报告立足聚合物基导热界面材料（TIM）新视角，聚焦行业核心议题——变化趋势（怎么变）、用户需求（要什么）、投放选择（投向哪）、运营方法（如何投）及实践案例（看一看），期待携手行业伙伴，共谋行业发展新格局、新机遇，推动聚合物基导热界面材料（TIM）行业发展。

观点抢先知：

行业概述：聚合物基导热界面材料（TIM）是电子热管理的核心功能材料，以聚合物为基体、高导热填料为功能相，核心作用是填充发热器件与散热器间的微观间隙、驱逐空气、降低接触热阻，保障器件稳定高效运行。按照在电子元器件中的具体应用位置，热界面材料可划分为TIM1和TIM2两大类型。其中，TIM1是用于芯片与封装外壳之间的热界面材料，由于直接接触发热量巨大的芯片，这类材料需满足低热阻、高热导率的核心要求，同时热膨胀系数要与硅片高度匹配，且对电气绝缘性有着严苛标准。TIM2则是封装外壳与热沉之间的热界面材料，整体性能要求低于TIM1；TIM1通常采用高导热性粉体填充至含硅或非硅聚合物液体、相变聚合物中，最终形成浆状、泥状、膏状或薄膜状的复合材料，常见品类包括导热膏、导热胶、相变材料等。

行业政策：聚合物基导热界面材料（TIM）隶属新材料产业领域，而新材料产业是衡量国家科技竞争力与高端制造水平的核心支柱。国家高度重视该领域发展，已将新材料产业纳入战略性新兴产业重点培育方向，先后出台《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》《质量强国建设纲要》《前沿材料产业化重点发展指导目录（第一批）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025—2027年）》等一系列政策文件，从技术研发、产业化应用、标准体系建设、市场推广等多维度提供支持，为聚合物基导热界面材料行业突破高端技术壁垒、加速国产化替代、拓展新能源汽车、AI服务器等新兴应用场景筑牢政策根基。

全球TIM市场销售额：近年来，在AI、5G通信、新能源汽车、消费电子等下游核心应用领域的快速迭代驱动下，全球热界面材料市场规模呈稳步扩张态势。数据显示，2024年全球TIM市场销售额已达20.12亿美元，预计到2031年将攀升至41.48亿美元，2025至2031年期间年复合增长率高达10.74%，行业整体增长动能强劲。

中国TIM市场销售额：在国内市场，随着5G技术全面商用化落地、电子材料国产化替代进程加速推进，叠加导热散热材料在新能源汽车、动力电池、数据中心等新兴领域的应用场景持续拓宽，我国热界面材料市场迎来发展黄金期。2024年中国TIM市场规模已突破10.27亿美元，预计2031年将增长至21.64亿美元，年复合增长率达到11.09%，增速显著高于全球平均水平，展现出强劲的发展潜力。

细分市场情况：“AI+”浪潮的全面席卷将持续拉动电子器件的高端散热需求，尤其在数据中心、高级驾驶辅助系统（ADAS）、消费电子、电动汽车等领域表现突出。数据中心领域正从“智能计算”向“智算中心”升级，市场投入保持高速增长；ADAS领域中，传感器、摄像头、处理器等核心电子组件的集成度不断提升，运行过程中产生的热量持续增加，散热问题已成为制约产品性能与安全性的关键瓶颈，若热管理不当，不仅会影响计算效率，更可能造成器件永久性损坏，引发技术与安全风险。据预测，到2033年，ADAS传感器和电子控制单元（ECU）对应的TIM市场规模将达到6亿美元，成为行业重要的增量市场。

企业竞争格局：中国聚合物基导热界面材料行业的竞争格局，清晰地呈现出“国际巨头主导高端、本土企业追赶并实现结构性突破”的动态平衡态势。以德国汉高、美国陶氏化学、日本信越化学等为代表的国际化工材料巨头，凭借数十年的技术积淀、深厚的专利壁垒和全球化客户体系，在半导体封装、高端通信设备等对材料性能与可靠性要求严苛的高端市场占据着主导地位。与此同时，以回天新材、飞荣达、中石科技、鸿富诚等为代表的本土领军企业，已从早期依赖成本优势和本地化服务、主导消费电子等中低端市场的阶段，成功迈入新的发展层级。它们通过持续的“产学研”协同研发，不仅在高导热、无硅化等关键技术领域取得实质性突破，更已成功切入新能源汽车、5G基站及部分先进封装等高端供应链，从过去的“追赶者”转变为在特定赛道与巨头直接竞争的“有力参与者”，正系统性推动国产化率提升与市场格局的重塑。

行业发展趋势：中国聚合物基导热界面材料行业未来将围绕技术升级、国产替代与场景适配三大核心方向演进：技术层面，将聚焦高导热纳米填料复合、无硅化配方优化及多功能集成创新，推动材料向更高导热效率、更优环境兼容性及智能响应特性升级；产业层面，产业链协同深化趋势显著，本土企业将加速突破高端填料等上游关键材料瓶颈，依托政策扶持与产学研合作完善标准体系，推动国产化替代从消费电子向半导体封装、高端车规等领域延伸；应用层面，伴随AI服务器、5G基站、新能源汽车等高端装备迭代，定制化解决方案成为竞争核心，企业将深化与终端客户的协同开发，精准匹配不同功率密度与工况需求，拓展细分市场空间。

报告相关内容节选：

报告目录：

第一章 聚合物基导热界面材料概述

第一节 聚合物基导热界面材料定义

第二节 聚合物基导热界面材料发展历程

第三节 聚合物基导热界面材料产品主要分类

第四节 聚合物基导热界面材料主要应用领域分析

第二章 2025年中国聚合物基导热界面材料行业发展环境分析

第一节 聚合物基导热界面材料行业经济环境分析

第二节 聚合物基导热界面材料行业政策环境分析

第三节 聚合物基导热界面材料行业技术环境分析

第三章 世界聚合物基导热界面材料行业市场运行形势分析

第一节 2021-2025年全球聚合物基导热界面材料行业发展概况

第二节 世界聚合物基导热界面材料行业发展走势

一、全球聚合物基导热界面材料行业市场分布状况分析

二、全球聚合物基导热界面材料行业发展趋势预测

第四章 中国聚合物基导热界面材料行业供给与需求情况分析

第一节 中国聚合物基导热界面材料行业总体规模

第二节 中国聚合物基导热界面材料行业供给概况

第三节 中国聚合物基导热界面材料行业需求概况

第五章 中国聚合物基导热界面材料所属行业规模与效益分析

第一节 2021-2025年中国聚合物基导热界面材料制造所属行业盈利能力分析

第二节 2021-2025年中国聚合物基导热界面材料制造所属行业发展能力

第三节 2021-2025年聚合物基导热界面材料制造所属行业偿债能力分析

第四节 2021-2025年聚合物基导热界面材料制造企业数量分析

第六章 2021-2025年聚合物基导热界面材料上、下游行业发展现状与趋势预测分析

第一节 聚合物基导热界面材料上游行业发展分析

- 一、聚合物基导热界面材料上游行业发展现状调研
- 二、聚合物基导热界面材料上游行业发展趋势预测分析
- 第二节 聚合物基导热界面材料下游行业发展分析
- 一、聚合物基导热界面材料下游行业发展现状调研
- 二、聚合物基导热界面材料下游行业发展趋势预测分析

第七章 2021-2025年聚合物基导热界面材料行业竞争格局分析

第一节 聚合物基导热界面材料行业集中度分析

- 一、聚合物基导热界面材料市场集中度分析
- 二、聚合物基导热界面材料企业集中度分析
- 三、聚合物基导热界面材料区域集中度分析

第二节 聚合物基导热界面材料行业竞争格局分析

- 一、行业内竞争
- 二、供应商议价能力
- 三、客户议价能力
- 四、进入威胁
- 五、替代威胁

第八章 聚合物基导热界面材料行业重点企业竞争力分析

第一节 道康宁（Dow Corning）公司

- 一、企业简介
- 二、企业经营状况及竞争力分析

第二节 德国汉高公司

- 一、企业简介
- 二、企业经营状况及竞争力分析

第三节 霍尼韦尔（中国）有限公司

- 一、企业简介
- 二、企业经营状况及竞争力分析

第四节 莱尔德科技有限公司（Laird Technologies）

- 一、企业简介
- 二、企业经营状况及竞争力分析

第五节 3M公司

- 一、企业简介
- 二、企业经营状况及竞争力分析

第六节 德国赛米控公司（SEMİKRON）

- 一、企业简介
- 二、企业经营状况及竞争力分析

第九章 聚合物基导热界面材料行业企业经营策略研究分析

- 第一节 聚合物基导热界面材料企业多样化经营策略分析
- 第二节 大型聚合物基导热界面材料企业集团未来发展策略分析
- 第三节 对中小聚合物基导热界面材料企业生产经营的建议

第十章 中国聚合物基导热界面材料产业市场竞争策略建议

第一节 聚合物基导热界面材料行业发展战略研究

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略
- 三、业务组合战略
- 四、区域战略规划
- 五、营销品牌战略
- 六、竞争战略规划

第二节 中国聚合物基导热界面材料产业竞争战略建议

- 一、聚合物基导热界面材料竞争战略选择建议
- 二、聚合物基导热界面材料产业升级策略建议
- 三、聚合物基导热界面材料产业转移策略建议
- 四、聚合物基导热界面材料价值链定位建议

第十一章 中国聚合物基导热界面材料行业未来发展预测及投资前景分析

第一节 未来聚合物基导热界面材料行业发展趋势预测

- 一、未来聚合物基导热界面材料行业发展分析
- 二、未来聚合物基导热界面材料行业技术开发方向

第二节 2026-2032年聚合物基导热界面材料行业运行状况预测分析

- 一、2026-2032年聚合物基导热界面材料行业产量预测分析
- 二、2026-2032年聚合物基导热界面材料行业需求预测分析

第十二章 中国聚合物基导热界面材料行业投资的建议及观点

第一节 聚合物基导热界面材料行业投资机遇

- 一、中国当前经济形势对聚合物基导热界面材料行业的影响
- 二、聚合物基导热界面材料企业在危机中的竞争优势
- 三、战略联盟的实施

第二节 聚合物基导热界面材料行业投资风险

第三节 聚合物基导热界面材料行业应对策略

图表目录

图表 聚合物基导热界面材料产业链

图表 国内生产总值情况 单位：亿元

图表 固定资产投资情况 单位：亿元

图表 社会消费品零售总额情况 单位：亿元

图表 进出口贸易情况 单位：亿元

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/1246053.html>